

元脑®服务器

NE5260G7

面向边缘多场景的全能型边缘服务器



产品简介

NE5260G7是一款基于第四代和第五代英特尔®至强®可扩展处理器设计的2U 双路边缘服务器,其符合最新开放计算 OTII 2U 2.0标准,在计算、存储、可扩展性方面实现极致设计;具有环境适应性强、尺寸小、架构灵活的特点,支持前、后IO等多种部署方式,既能支持十余种边缘AI加速卡选择,又能提供上百 TB 级边缘存储容量,全面满足通信、能源、交通、制造、互联网等行业的边缘场景多样化需求。

适用机型说明

产品型号	维护方式	散热方式
NE5260-M7-A0-F0-00	前维护	风冷
NE5260-M7-A0-R0-00	后维护	风冷

产品特性

架构紧凑，性能卓越	集智创新，灵活多变
■ 支持双路第四代/第五代英特尔®至强®可扩展处理器，单处理器最高32核心，225W TDP ■ 配备16个DDR5 ECC RDIMM内存插槽，支持4800/5600MT/s速率，显著提升系统性能与稳定性 ■ 深度仅450mm，符合OTII 2U 2.0规范，适配边缘机房空间限制，支持快速部署	■ 专为边缘AI优化，可选配2张双宽或6张单宽GPU加速卡，满足不同算力需求 ■ 模块化存储设计支持混合配置：8×2.5英寸或4×3.5英寸+4×2.5英寸，内置双M.2 SSD扩展 ■ 提供4G/5G/WiFi多模组扩展方案，确保复杂环境下的可靠网络接入
智慧运维，高效管控	稳定可靠，环境适应
■ 基于上百颗传感器的检测，配合智能温控策略，精准控制部件温度和整机功耗 ■ 云端智能运维平台支持远程诊断，降低现场维护频次，节省运维成本 ■ 支持前、后IO两种维护方式设计，免工具拆装，OCP网卡支持带电更换	■ 双BMC冗余架构支持热切换，固件在线升级不影响业务连续性 ■ 优化散热结构设计和散热调控策略，可满足低噪音人机共存使用 ■ 板卡均采用三防涂层工艺，可选前窗防尘罩，适应0~45℃的高温、高湿、灰尘等恶劣环境

产品规格

组件	描述		
规格	2U机架式		
处理器	支持1颗或2颗第四代和第五代英特尔®至强®可扩展处理器，单CPU最大支持32核，最大热设计功率225W		
内存	支持最多16条DDR5 4800MT/s或5600MT/s内存，单颗CPU支持8条DIMM，双CPU配置下支持16条DIMM，兼容RDIMM类型		
存储	前IO (8 * 2.5前窗)	后IO (4*2.5 前窗)	前IO (4 * 3.5 + 4 * 2.5前窗)
	前置:8*2.5"硬盘	前置:4*2.5"硬盘	前置:4*3.5" +4*2.5"硬盘
	后置:-	后置:4*2.5"硬盘	后置:-
	内置:2 * SATA/NVMe M.2 SSD		
I/O扩展插槽	最大支持6个PCIe4.0 x16插槽 + 1个热插拔OCP 3.0x8插槽		最大支持2个PCIe 4.0 x16插槽+1个OCP 3.0 x8插槽
网络	板载2个1G RJ45网口,可选1个OCP3.0 SFF网络子卡		
接口	3个USB 3.0接口, 1个USB 2.0接口, 2个DB15 VGA接口, 1个Micro USB串口, 1个RJ45管理网口		
电源	支持1+1冗余800W/1300W/1600W/2000W CRPS标准电源		
风扇	4个热插拔N+1冗余风扇		
操作系统	KOS, Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise, SUSE Linux Enterprise Server, CentOS等		
尺寸	W(宽)447mm;H(高)87mm;D(深)450mm		
工作温度	0~45℃ (具体详情请参考技术白皮书)		